

初級

半導体実装概論

2024年8月2日(金) 10:00~17:00

講師

大阪大学フレキシブル3D実装協働研究所
所長/特任教授/名誉教授

菅沼 克昭 氏

先端半導体パッケージの進化

微細接合技術

サブストレート

樹脂封止・絶縁技術

パワー半導体

パッケージ信頼性

まとめ

半導体パッケージの進化、その中での微細接合技術とサブストレート技術、樹脂封止と絶縁技術の材料とプロセス、更にパッケージの信頼性として評価技術や熱特性のシミュレーション技術を解説し、最後に今後のパッケージングについてお話しします。

開催日

2024年8月2日(金) 10:00~17:00

開催形態

ハイブリッド開催(対面+オンライン)

受講料

税込 33,000円

福岡県内中小企業の方には、
受講料補助制度があります

定員

対面 40名 オンライン 90名

- 対面、オンラインは同価格です ● 申込みには、「ふくおかIST e-learning」への会員登録が必要です
- お支払い後、当日の参加有無にかかわらず返金はいたしません ● 福岡県内中小企業の方には、受講料補助制度(下記参照)があります
- 講座当日、全受講者にpdfテキスト(コピー・印刷不可、コメント追加可)配布、対面受講者には紙テキストも配布します
なおテキストの無断転載・複製等は禁止しています
- オンライン受講は2画面(画面拡張モード:Zoom画面とpdfテキスト画面)を推奨します
- 特段の事情が発生した場合、やむを得ず中止又は延期する場合がございます



対面受講会場

福岡システムLSI
総合開発センター
2階 講義室
福岡市早良区百道浜3-8-33

オンライン会場

Zoom
接続先は
お支払い完了後ご案内

お申込み方法 - お申込み期間は6月24日(月) 9:00 から 7月30日(火) 17:00まで -



下記HPより「半導体実装概論」の対面またはオンラインを選択してお申込みください

<https://e-learning.ist-college.org/contents/category/seminar-live>

ふくおかIST e-learning

検索



「講座・セミナー等申込」をクリック

【本講座に関するお問い合わせ】 公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 福岡半導体リスティングセンター 担当:高倉・浜崎
e-mail : reskilling_contact@ist.or.jp TEL : 092-822-1550

この講座でお使いいただけます！

福岡県内中小企業の方は

(消費税及び地方消費税を除く)

受講料全額補助！！

補助には条件がございます。
お申込みの前に福岡半導体
リスティングセンターのホーム
ページより、申請要領・交
付要綱をご確認ください。
「ふくおかIST e-learning」の
講座申込画面からもリンクで
ジャンプできます。